

半导体行业PLASMA处理 及性能检测整体解决方案

清洗

活化

除胶

刻蚀

检测

针对半导体行业设计的PLASMA处理及性能检测整体解决方案
可根据产品特性及客户需求,提供射频等离子自动化系统或微波等离子自动化系统
并提供完善的在线式及腔体式产品系列予以选择

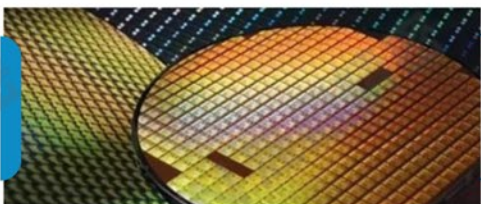


芯片粘接前处理

去除材料表面污染物,增加表面润湿性能,
提升胶体流动性,保证与其他材料的结合能力。

塑封前处理

去除材料表面污染物,使芯片表面与塑封材
料结合牢固,减少分层与气泡等不良的产生。

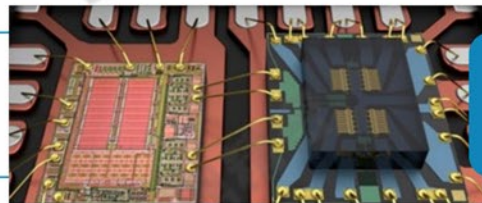


光刻胶去除

去除残留的光刻胶及其他有机物,活化和粗化
晶圆表面,提高晶圆表面润湿性能。

金属键合前处理

去除金属焊盘上的有机污染物,提高焊接
工艺的强度和可靠性。





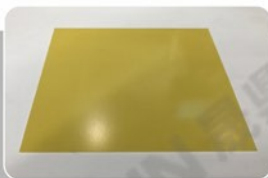
◀ (SPV-12Z)

- 轨道间距可调, 兼容性强, 兼容产品长180-280mm×宽25-90mm。
- 四道同时上料, 双工位切换处理, 提升产能。
- 一体式电极板设计, 等离子体密度高, 处理效果好, 均匀性好。
- 工控系统控制, 一键式操作, 自动化程度高, 配备自动取料、传输、送料等功能, 减少人为操作导致二次污染。

设备尺寸	长1650mm×宽1318mm×高1803mm
RF电源	功率0-600W 频率13.56MHZ
容积	12升 (长500×宽340×高70mm)
电极尺寸	300×570mm
轨道数量	4条×2 (分为待料区与处理区)
气路配置	标配两路, 氩气/氧气 (可定制)
系统控制	工控系统

在线片式真空等离子清洗机

Fr4板刻蚀 ▼



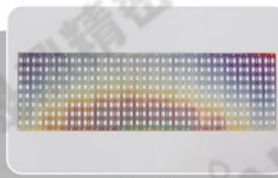
◀Fr4板处理前

实验序号	刻蚀前 (g)	刻蚀后 (g)
A	11.17	10.92
B	11.14	10.88
C	11.19	10.82



◀Fr4板处理后

引线框架还原处理 ▼



处理前



处理后

